



平成 25 年 2 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク  
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎  
(コード番号 7468)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井和明  
(TEL 03-5302-1569)

**半導体販売事業の承継等に関するお知らせ**  
**(会社分割(吸収分割)による吸収分割承継会社への事業承継及び当該吸収分割承継会社株式の一部譲渡(子会社の異動)について)**

当社は、平成 25 年 2 月 1 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の国内顧客向け半導体販売事業を会社分割(吸収分割)により当社が設立する予定の 100%子会社(以下「吸収分割承継会社」といいます。)に承継させ(以下「本会社分割」といいます。)、当社が当該吸収分割承継会社の株式の 60%を Serial Microelectronics Pte Ltd(以下「シリアル社」といいます。)に対して譲渡すること(以下「本株式譲渡」といいます。)について決議いたしましたので、お知らせいたします。

**I 会社分割(吸収分割)による吸収分割承継会社への事業承継について**

**1. 当該会社分割の目的**

当社が属する半導体・半導体関連電子機器市場は、東日本大震災の復旧・復興に伴う産業機器、自動車、環境・エコロジー関連製品等の特需、新しい通信メディア(スマートフォン、タブレット PC 等)の普及等により特定分野で活況を見せた一方で、継続する円高傾向と個人消費意欲の停滞等による国内経済環境の不透明感、欧州金融危機、新興国経済発展の鈍化、原材料価格の上昇等の不安材料が多い中、予断を許さない状況となっております。更に、国内電子機器メーカーによる中国や ASEAN への生産等の拠点を移転する動きは、ますます加速しており、そのような国内電子機器メーカーに対しての一貫したサービス体制の強化が必要となっております。こうした厳しい環境の中、国内電子機器メーカーへの販売市場においては、国内のみならず海外半導体商社も含めて企業間競争は熾烈を極め、企業買収や合併、大規模な事業再構築が頻繁に行われるなど、業界の再編が急速に進んでおります。

このような状況下、当社は既存事業の深耕に加え、得意とするアナログ半導体を軸に、新規商材、新規事業の開拓・立ち上げに注力するとともに、「選択と集中」により、取扱う商材、取組む事業を検証し、長期的な経営プランの策定・実行を推進いたしました

が、平成 24 年 3 月期の連結業績は、平成 23 年 3 月期に 22,502 百万円あった売上高が 16,238 百万円（前期比 27.8%減）となり、損益については、経常利益が 99 百万円（前期比 63.0%減）、純利益は 71 百万円（前期比 69.0%減）と大幅に減少する結果となりました。

平成 25 年 3 月期は前述の経営プランを推進するために、平成 24 年 4 月 1 日をもって、昭和 54 年 11 月から半導体の販売代理店契約を締結していたテキサス・インスツルメンツ社製品の販売等に関する事業を東京エレクトロニクス株式会社の 100%子会社であるパネトロン株式会社に売却することにより財政状態の改善を図り、一方では平成 24 年 8 月に、コネクタ専門メーカーのヒロセ電機株式会社と取扱店契約を締結することにより、従来の半導体ソリューション提案に加え、ヒロセ電機株式会社の技術革新型コネクタをラインナップに加えることにより、顧客満足度向上と共にビジネスの拡大を目指して取り組んでまいりました。

しかしながら、当社の主要な取引先であり、昭和 60 年 12 月から半導体の販売代理店契約を締結していた世界第 7 位の半導体メーカーであるエス・ティー・マイクロエレクトロニクス株式会社（以下「ST 社」といいます。）より、平成 24 年 10 月に販売代理店の展開方針の変更の連絡を受け、今後の契約について協議した結果、当社が ST 社との間で締結している販売代理店契約を平成 25 年 6 月 30 日付で解消する見込みとなったことから、当該解消に向けて ST 社との間で手続を進めることを、平成 24 年 12 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました（平成 24 年 12 月 28 日付「エス・ティー・マイクロエレクトロニクス株式会社との販売代理店契約解消に関するお知らせ」をご参照ください。）。

このような事態の発生により、今後、当社の売上高がさらに減少する見込みのため、当社は平成 25 年 1 月 7 日開催の当社取締役会において、希望退職制度による人員削減策を実施することを決議する等、根本的な経営改革、大規模な事業再構築を模索して参りました（平成 25 年 1 月 7 日付「希望退職者の募集に関するお知らせについて」をご参照ください。）。

加えて、当社の取扱い商材数が大幅に減少する見込みとなったことから、他のサプライヤーとの取引関係にも支障をきたし、当社との販売店契約を解消される可能性が高いと考えられ、今後の事業の方向性並びに継続性について当社内で慎重に検討を重ねました。

そうした中、本社をシンガポールにおき、東南アジア及び日本を除く東アジアで事業を展開する、シンガポール証券取引所に上場し半導体の販売事業等を営む Serial System Ltd の完全子会社であるシリアル社より、当社に対し、シリアル社を主導とした合弁会社の形態により当社の国内顧客向け半導体販売事業を継続するという提案を受けました。当該提案について両社で協議を進め、本会社分割及び本株式譲渡を実施し当社の国内顧客向け半導体販売事業を継続させつつ、当社はこれまでの半導体販売事業

において培った自己及びシリアル社の販売ネットワーク網を活用して、既存の取引先との関係維持等を目的とした事業をベトナムその他の海外で立ち上げることで、吸収分割承継会社、当社及びシリアル社のシナジーを図るとの共通認識に達しました。当社はシリアル社との協議を踏まえ、今後の当社の事業運営についてさらに検討を重ねた結果、ST社との契約の解消により、仮に、他のサプライヤーとの契約も解消された場合、当社単独での事業継続は困難であると考えられること、かかる事態を回避するためには、早急に現状を打開するための措置を採る必要があるところ、本会社分割及び本株式譲渡以外の選択肢では、他のサプライヤーとの取引関係を継続できるか疑問が残ること、一方で、本会社分割及び本株式譲渡は、①当社の海外拠点とシリアル社の拠点との補完性が高いこと、②シリアル社は、当社が経営上の重要な契約を締結するオン・セミコンダクター社（平成12年1月に、昭和50年6月に当社と販売代理店契約を締結したモトローラ社から分社化した会社となります。以下「オンセミ社」といいます。）との間で、日本以外の東アジア地域の販売店契約を締結しており、その点においても当社との相乗効果が高いこと、③シリアル社の取り扱っている多くの商材が当社の国内顧客向け半導体販売事業の取扱い商材に加わることにより、当該事業の国内での販売力を高めることができること等の事業シナジーがあることから、本会社分割及び本株式譲渡を実施することが当社の企業価値の毀損を回避し、中長期的な当社の企業価値の維持・向上を目指す上で最良の選択であるとの結論に至りました。

以上から、当社は、平成25年2月1日開催の当社取締役会において本会社分割及び本株式譲渡の実施について決議いたしました。

## 2. 当該会社分割の要旨

### (1) 当該会社分割の日程

本会社分割取締役会決議日	平成25年2月1日
本会社分割契約締結日	平成25年3月（予定）
株主総会基準日公告日	平成25年3月26日（予定）
株主総会基準日	平成25年4月10日（予定）
株主総会開催日	平成25年5月8日（予定）
効力発生日	平成25年5月15日（予定）
金銭交付日	平成25年5月15日（予定）

### (2) 当該会社分割の方式

当社を分割会社とし、吸収分割承継会社を承継会社とする吸収分割です。

### (3) 当該会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際して、吸収分割承継会社は、当社に対して、金437,000,000円を交

付する予定です。

(4) 当該会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  
該当事項はございません。

(5) 会社分割により増減する資本金  
本会社分割により当社の資本金の増減は予定しておりません。

(6) 承継会社が承継する権利義務  
吸収分割承継会社は、分割効力発生予定日である平成 25 年 5 月 15 日において、当社が運営する国内顧客向け半導体販売事業に関する資産の一部及び契約上の地位等の権利義務を承継する予定です。

(7) 債務履行の見込み  
当社及び吸収分割承継会社において、本会社分割後の資産の額を負債の額が上回る  
ことが見込まれ、また、本会社分割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような  
事態は現在のところ予定されておりません。したがって、本会社分割後において、当  
社及び吸収分割承継会社の負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断  
しております。

### 3. 当該会社分割の当事会社の概要

	分割会社 平成 25 年 2 月 1 日現在	承継会社 平成 25 年 3 月 1 日設立予定
(1) 名 称	株式会社アムスク	株式会社シリアル・アムスク・マイクロエレクトロニクス (予定)
(2) 所 在 地	東京都渋谷区代々木一丁目 11 番 2 号代々木コミュニティビル	東京都渋谷区代々木一丁目 11 番 2 号代々木コミュニティビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 栗原 新太郎	未定
(4) 事 業 内 容	電子機器・部品の販売	電子機器・部品の販売
(5) 資 本 金	10 億 5174 万円	3 億円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 50 年 1 月 13 日	平成 25 年 3 月 1 日 (予定)
(7) 発 行 済 株 式 数	515 万 8,230 株	6,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	12 月 31 日
(9) 従 業 員 数	88 名	35 名 (予定)
(10) 主 要 取 引 先	オン・セミコンダクター	—

	株式会社					
(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行	未定				
(12) 大株主及び持株比率	栗原暎子 21.48% 栗原新太郎 19.58%	株式会社アムスク 100%				
(13) 当事会社間の関係						
資本関係	吸収分割承継会社は、当社が100%出資する子会社です（設立時）。					
人的関係	当社の役員又は従業員が、吸収分割承継会社の役員を兼務する予定です（設立時）。					
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。					
関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社に該当し、当社の関連当事者に該当します。					
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決算期	当社（連結）			株式会社シリアル・アムスク・マイクロエレクトロニクス（連結）		
	22年 3月期	23年 3月期	24年 3月期	22年 12月期	23年 12月期	24年 12月期
連結純資産	4,036	4,145	4,204	—	—	—
連結総資産	7,690	8,505	8,632	—	—	—
1株当たり連結純資産(円)	830.79	867.59	879.86	—	—	—
連結売上高	15,631	22,502	16,238	—	—	—
連結営業利益	△50	337	124	—	—	—
連結経常利益	△93	293	99	—	—	—
連結当期純利益	△179	230	71	—	—	—
1株当たり連結当期純利益 (円)	△36.90	47.98	14.95	—	—	—
1株当たり配当金(円)	1.00	8.00	5.00	—	—	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注) 吸収分割承継会社は、平成25年3月1日設立予定のため、上記記載内容は現時点での「予

定」です。

(注) 吸収分割承継会社は、平成 25 年 3 月 1 日設立予定のため、実績はありません。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

オンセミ社の汎用ロジック製品、特定用途向け IC である ASSP (ASIC) 製品や、同社が平成 23 年に買収した三洋半導体株式会社製のモータードライバー製品群を車載マーケットに販売することを中核の事業として、電子部品、電源等多岐に亘る商材を産業機器、民生向けに販売しております。

##### (2) 分割承継する部門の経営成績 (平成 24 年 3 月期)

(単位：百万円)

	分割承継対象事業 (a)	当社 (連結) (b)	比率 (a/b)
売上高	3,013	16,238	18.56%

(注) 当社 (連結) 売上高には、平成 24 年 4 月 1 日に販売等に関する事業を譲渡いたしましたテキサス・インスツルメンツ社製品の売上高 9,140 百万円及び平成 25 年 6 月 30 日に販売代理店契約を解消する見込みの ST 社製品の売上高 3,963 百万円が含まれております。

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (平成 24 年 12 月 31 日現在)

(単位：百万円)

資産	
項目	帳簿価格
流動資産	330
固定資産	26
合計	356

(注) 本会社分割による承継対象に負債を含む予定はございません。

#### 5. 当該会社分割後の状況

		吸収分割承継会社
(1)	名称	株式会社シリアル・アムスク・マイクロエレクトロニクス
(2)	所在地	東京都渋谷区代々木一丁目 11 番 2 号 代々木コミュニティビル
(3)	代表者の役職・氏名	未定

(4) 事業内容	電子機器・部品の販売
(5) 資本金	3億円
(6) 決算期	12月31日

(注) 吸収分割承継会社は、平成25年3月1日設立予定のため、上記記載内容は現時点での「予定」です。

## II 吸収分割承継会社株式の一部譲渡（子会社の異動）について

### 1. 吸収分割承継会社株式の譲渡の理由

当社がシリアル社に対して吸収分割承継会社株式の60%を譲渡する理由につきましては、上記I1をご参照ください。

### 2. 異動する子会社（吸収分割承継会社）の概要

(1) 名称	株式会社シリアル・アムスク・マイクロエレクトロニクス	
(2) 所在地	東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 代々木コミュニティビル	
(3) 代表者の役職・氏名	未定	
(4) 事業内容	電子機器・部品の販売	
(5) 資本金	3億円	
(6) 設立年月日	平成25年3月1日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社アムスク 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	吸収分割承継会社は当社が100%の出資をする子会社となります（設立時）。
	人的関係	当社の役員又は従業員が、吸収分割承継会社の役員を兼務する予定です（設立時）。
	取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	Serial Microelectronics Pte Ltd
(2) 所在地	8 Ubi View, #04-01, Serial System Building, Singapore 408554
(3) 代表者の役職・氏名	Derek Goh Bak Heng
(4) 事業内容	電子機器・部品の販売
(5) 資本金	S\$22,500,000
(6) 設立年月日	1994年4月16日
(7) 純資産	S\$23,728,075

(8) 総 資 産	S\$103,696,046	
(9) 大株主及び持株比率	Serial System Ltd 100%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(注) 「S\$」は、「シンガポールドル」を意味します。

#### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	6,000 株 (議決権の数：6,000 個) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲 渡 株 式 数	3,600 株 (議決権の数：3,600 個)
(3) 譲 渡 価 額	吸収分割承継会社の普通株式 180 百万円 合計 (概算額) 180 百万円
(4) 異動後の所有株式数	2,400 株 (議決権の数：2,400 個) (議決権所有割合：40%)

#### 5. 株式譲渡の日程

(1) 取 締 役 会 決 議	平成 25 年 2 月 1 日
(2) 株 式 譲 渡 契 約 日	平成 25 年 2 月 1 日



(3) 株式譲渡日	平成25年5月15日(予定)
-----------	----------------

### Ⅲ. 今後の見通し

今後、当社はこれまでの国内顧客向け半導体販売事業において長年培われた販売ネットワーク網を活用した事業の立上げを模索しておりますが、かかる事業から安定的に収益を得られるようになるには一定の時間を要すると考えられるため、本会社分割及び本株式譲渡が完了する予定の平成25年6月以降、当社の事業は実質的に吸収分割承継会社株式の持分のうち40%を保有することのみとなり、主な収益は吸収分割承継会社からの配当収入のみとなります。当社は、仮に、このような状況に陥った場合には、当社普通株式は、早ければ本会社分割及び本株式譲渡が完了した時点で、株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準（JASDAQにおける有価証券上場規程第47条第1項第8号に規定される「事業活動の停止」）に抵触するおそれがあると危惧しております。

そこで、当社が自己株式の取得を実施し、株主の皆様へ、当社株式の売却による投下資本回収の機会を等しくご提供することが、株主の皆様に対する最善の措置であり、その具体的方法としては、上限を設けない自己株式の公開買付けを実施することが適切な対応であると判断し、平成25年2月1日開催の当社取締役会において、自己株式の取得及び当社普通株式の非公開化を目的とした自己株式の公開買付けの実施を合わせて決議いたしました（平成25年2月1日付「自己株式の取得及び当社普通株式の非公開化を目的とした自己株式の公開買付けに関するお知らせ」をご参照ください。）。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成25年2月1日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成25年3月期)	6,344	△446	△549	△336
前期連結実績 (平成24年3月期)	16,238	124	99	71